

TOSHIBA

東芝メモリ株式会社 略語集

Ver.2
2018年 7月

© 2018 Toshiba Memory Corporation

略語集

* 印は当社の社内用語を示す。

AC	Alternating Current	交流電流
AES	Auger Electron Spectroscopy	オージェ電子分光法
AFM	Atomic Force Microscope	原子間力顕微鏡
AQL	Acceptable Quality Level	合格品質水準
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	特定用途向けカスタム集積回路
ATPG	Automatic Test Pattern Generator	テストパターン自動生成
EBテスト	Electron Beam Tester	電子ビームテスト
BEM	Breakdown Energy of Metal	金属配線に大電流を流し溶断するまでのエネルギー量で評価する方式
BM	Barrier Metal	バリアメタル
BPSG	Boro Phospho Silicate Glass	硼素リンケイ酸ガラス
BTI	Bias Temperature Instability	
CAD	Computer Aided Design	コンピュータ支援による設計
CCD	Charge Coupled Device	電荷結合素子
CDM	Charged Device Model	デバイス帯電モデル
CIM	Computer Integrated Manufacturing	コンピュータをベースとした生産管理システム
* CL	Contractual Liability	契約責任
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor	相補性金属酸化膜半導体
CMP	Chemical Mechanical Polishing	化学機械研磨法
CTR	Current Transfer Ratio	電流変換効率
CVD	Chemical Vapor Deposition	化学反応による気相成長
* DAT	Design Approval Test	設計認定試験
DC	Direct Current	直流電流
DIP	Dual Inline Package	リード・ピンが2直列並行に配置されているパッケージ
DL	Defect Level	欠陥レベル
DLTS	Deep Level Transient Spectroscopy	不純物準位分光評価
DR	Design Review	設計審査

略語集

ECP	Environmentally Conscious Products	環境調和型製品
EBIC	Electron Beam Induced Current	電子線誘起電流
EEPROM	Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory	記憶内容を電氣的に書き換え可能な読み出し専用メモリ
EM	ElectroMigration	エレクトロマイグレーション
EPMA	Electron Probe X-ray Micro Analyzer	X線マイクロアナライザー、電子線マイクロアナライザー
EPROM	Erasable and Programmable Read Only Memory	消去可能な再書き込み可能な読み出し専用メモリ
ESD	ElectroStatic Discharge	静電気放電
ESR	Electron Spin Resonance	電子スピン共鳴
FBGA	Fine pitch Ball Grid Array	BGA(パッケージ)種類の1つ
FIB	Focused Ion Beam	集束イオンビーム
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis	故障モード及びその影響度解析
FTA	Fault Tree Analysis	故障の木解析
FT-IR	Fourier Transform Infrared Spectroscopy	フーリエ変換赤外分光
HBM	Human Body Model	人体帯電モデル
HCI	Hot Carrier Injection	ホットキャリア注入
IC	Integrated Circuit	集積回路
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
ISS	Ion Scattering Spectroscopy	イオン散乱エネルギー分光
LCC	Leadless Chip Carrier package	リードのない小型、高密度用パッケージ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
LEELS	Low Energy Electronic Loss Spectroscopy	低速電子エネルギー損失分光
LSI	Large Scale Integration	大規模集積回路
LQFP	Low profile Quad Flat Package	QFP(パッケージ)種類の1つ
LTPD	Lot Tolerance Percent Defective	Lot 許容不良率

略語集

MM	Machine Model	マシンモデル
MSDS	Material Safety Data Sheet	化学物質安全性データシート
MTBF	Mean Time Between Failures	平均故障間隔時間
MTF	Median Time to Failure	メジアン故障寿命
MTTF	Mean Time To Failure	平均故障寿命
NBTI	Negative Bias Temperature Instability	負バイアス不安定性
OBIC	Optical Beam Induced Current	光励起電流法
OBIRCH	Optical Beam Induced Resistance CHange	光ビーム加熱抵抗変化検出法(オバーク)
ONO	Oxide Nitride Oxide	SiO ₂ /SiN/SiO ₂ (ONO)の3層構造
OSF	Oxidation induced Stacking Fault	酸化誘起積層欠陥
PAT	Production Approval Test	量産品質認定試験
PCB	Printed Circuit Board	プリント回路基板
PDA	Personal Digital Assistant	携帯情報端末
PEM	Photo Emission Microscopy	エミッション顕微鏡
PEP	Photo Etching Process	写真蝕刻工程
PGA	Pin Grid Array package	パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ
PIXE	Particle Induced X-ray Emission	粒子線励起X線
PL	Product Liability	製造物責任
QAT	Quality Approval Test	量産試作品認定試験
QFP	Quad Flat Package	四方にリードのあるフラットパッケージ
RBS	Rutherford Backscattering Spectrometry	ラザフォード後方散乱
RIE	Reactive Ion Etching	反応性イオンエッチング
SCM	Supply Chain Management	サプライチェーンマネジメント
SEM	Scanning Electron Microscope	走査電子顕微鏡
SILC	Stress Induced Leakage Current	
SIMS	Secondary Ion Mass Spectrometry	二次イオン質量分析装置
SIP	Single In line Package	ピン配列が片側一列だけになっているICパッケージ
SM	Stress Migration	ストレスマイグレーション
SMD	Surface Mounted Devices	面実装デバイス

略語集

SoC	System on Chip	
SPC	Statistical Process Control	統計的品質管理
SPM	Scanning Probe Microscope	走査形プローブ顕微鏡
SSOP	Shrink SOP (Small Outline Package)	SOP(パッケージ)種類の1つ
STM	Scanning Tunneling Microscope	走査形トンネル顕微鏡
TAT	Turn Around Time	納期、応答時間
TCP	Tape Carrier Package	ICチップをテープフィルムと接続し、樹脂を封止するTAB技術を用いたパッケージ
TDDDB	Time Dependent Dielectric Breakdown	経時絶縁破壊.酸化膜故障予測手段
TEG	Test Element Group	
TEM	Transmission Electron Microscope	透過電子顕微鏡
TOF-SIMS	Time Of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry	飛行時間型2次イオン質量分析装置
TPM	Total Productive Maintenance	全員参加の生産保全
TTF	Time To Failure	
UPS	Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy	紫外光励起光電子分光
VPS	Vapor Phase Soldering	蒸気相はんだ付け
XPS	X-ray Photoelectron Spectroscopy	X線光電子分光

ご注意

製品取り扱い上のお願い

東芝メモリ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、当社Webの「信頼性情報」など）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下「特定用途」といいます）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、救命・生命維持に関する医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA
